



# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

---

**Fibre optic active components and devices – Package and interface standards –  
Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-  
pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)**

**Composants et dispositifs actifs fibroniques – Normes de boîtier et d'interface –  
Partie 21: Guide de conception de l'interface électrique des boîtiers PIC utilisant  
des boîtiers matriciels à billes et à pas fins en silicium (S-FBGA) et des boîtiers  
matriciels à zone de contact plate et à pas fins en silicium (S-FLGA)**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

---

ICS 33.180.20

ISBN 978-2-8322-6636-6

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.  
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD.....	3
1 Scope.....	5
2 Normative references .....	5
3 Terms and definitions .....	5
4 Terminal position numbering.....	6
5 Code of package nominal dimensions.....	6
6 Symbols and drawings.....	6
7 Dimensions and tolerances.....	8
Bibliography.....	13
Figure 1 – S-FBGA and S-FLGA outline.....	7
Figure 2 – Mechanical gauge drawing.....	8
Figure 3 – Array of terminal-existence areas.....	8
Table 1 – Dimensions and tolerances .....	9
Table 2 – Combination list of D, E, $M_D$ , and $M_E$ for e = 0,30 mm pitch S-FBGA (informative) .....	11
Table 3 – Combination list of D, E, $M_D$ , and $M_E$ for e = 0,25 mm pitch S-FLGA .....	12

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

### **FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS –**

#### **Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)**

### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62148-21 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86C/1571/FDIS	86C/1577/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62148 series, published under the general title *Fibre optic active components and devices – Package and interface standards*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## **FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS –**

### **Part 21: Design guide of electrical interface of PIC packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)**

#### **1 Scope**

This part of IEC 62148 covers the design guide of the electrical interface for photonic integrated circuit (PIC) packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA) and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA). In this document, the electrical interface for the S-FBGA package is informative.

The purpose of this document is to specify adequately the electrical interface of PIC packages composed of optical transmitters and receivers that enable mechanical and electrical interchangeability of PIC packages.

#### **2 Normative references**

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-731, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 731: Optical fibre communication*

IEC TR 61931, *Fibre optic – Terminology*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	15
1 Domaine d'application .....	17
2 Références normatives .....	17
3 Termes et définitions .....	17
4 Numérotation des positions de bornes .....	18
5 Code des dimensions nominales de boîtier .....	18
6 Symboles et dessins .....	18
7 Dimensions et tolérances .....	20
Bibliographie.....	25
Figure 1 – Encombrement du S-FBGA et du S-FLGA .....	19
Figure 2 – Dessin de gabarit mécanique .....	20
Figure 3 – Matrice de zones d'existence de bornes .....	20
Tableau 1 – Dimensions et tolérances .....	21
Tableau 2 – Liste de combinaisons de $D$ , $E$ , $M_D$ , et $M_E$ pour $e =$ pas de 0,30 mm, S-FBGA (à titre informatif) .....	23
Tableau 3 – Liste de combinaisons de $D$ , $E$ , $M_D$ , et $M_E$ pour $e =$ pas de 0,25 mm, S-FLGA .....	24

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES – NORMES DE BOÎTIER ET D'INTERFACE –

#### **Partie 21: Guide de conception de l'interface électrique des boîtiers PIC utilisant des boîtiers matriciels à billes et à pas fins en silicium (S-FBGA) et des boîtiers matriciels à zone de contact plate et à pas fins en silicium (S-FLGA)**

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62148-21 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86C/1571/FDIS	86C/1577/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62148, publiées sous le titre général *composants et dispositifs actifs fibroniques – Normes de boîtier et d'interface*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.



## **COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES – NORMES DE BOÎTIER ET D'INTERFACE –**

### **Partie 21: Guide de conception de l'interface électrique des boîtiers PIC utilisant des boîtiers matriciels à billes et à pas fins en silicium (S-FBGA) et des boîtiers matriciels à zone de contact plate et à pas fins en silicium (S-FLGA)**

#### **1 Domaine d'application**

La présente partie de l'IEC 62148 traite du guide de conception de l'interface électrique destinée aux boîtiers de circuits intégrés photoniques (PIC) utilisant des boîtiers matriciels à billes et à pas fins en silicium (S-FBGA) et des boîtiers matriciels à zone de contact plate et à pas fins en silicium (S-FLGA). Dans le présent document, l'interface électrique destinée au boîtier S-FBGA est présentée à titre informatif.

L'objet du présent document est de spécifier de manière adéquate l'interface électrique des boîtiers PIC composés d'émetteurs et de récepteurs optiques qui permettent l'interchangeabilité électrique et mécanique des boîtiers PIC.

#### **2 Références normatives**

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60050-731, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 731: Télécommunications par fibres optiques*

IEC TR 61931, *Fibres optiques – Terminologie*